

## 概要

この通知は、Spartan®-3、Spartan-3E、および Spartan-3A FPGA 製品の全ワイヤボンダ パッケージ タイプにおいて金 (Au) ワイヤから銅 (Cu) ワイヤへ移行することをお知らせするものです。Cu ワイヤのアセンブリには、ハロゲン フリーかつ EU-ROHS 準拠のパッケージとグリーン モールド コンパウンドのみを使用します。これらのパッケージには REACH 規制の SvHC 物質は含まれていません。

## 内容

ザイリンクスでは、業界における現在の傾向に沿い、該当製品の長期的な需要に対応するために銅ワイヤへの転換を決定しました。銅ワイヤは、金ワイヤよりも優れた電気的および機械的特性を持つことが実証されています。ザイリンクスのアセンブリ サプライヤーは銅ワイヤ テクノロジーの評価を行っており、2008 年以降、量産製品で使用しています。予定されている生産能力の拡充は、銅ワイヤ パッケージのみを対象としています。

この変更によるパッケージの形状、フォーム、機能、または MSL レートへの影響はありません。Cu ワイヤ アセンブリでは、パッケージはハロゲン フリーかつ EU-RoHS に準拠しており、グリーン モールド コンパウンドを使用します。また、REACH 規制の SvHC 物質は含まれません。ザイリンクスは、錫リード (SnPb) はんだボールとリードフレームめっきを使用してアセンブリされたパッケージのサポートを継続します。

## 該当製品

この変更は、タイトルに記載されている製品ファミリの XC コマーシャル (C) およびインダストリアル (I) グレード製品の全スピード グレード、パッケージ、温度範囲のデバイスに該当します。オートモーティブ XA および航空宇宙/高信頼性 XQ デバイスへの影響はありません。

## キーデートおよび注文情報

[表 1](#) に記載のスケジュールで、金ワイヤを使用した製品と銅ワイヤを使用したものが混在出荷されます。

表 1 : Spartan-3 FPGA 製品の混在出荷スケジュール

デバイス	パッケージ	混在出荷の予定日
Spartan-3/-3E/-3A	VQ(G)100 TQ(G)144 PQ(G)208	2011 年 11 月
Spartan-3/-3E/-3A	CP(G)132 FT(G)256 FG(G)320 FG(G)400 FG(G)456 FG(G)484 FG(G)676 FG(G)900 FG(G)1156	2012 年 1 月*

\* 段階的導入の開始

## 品質評価データ

Cu ワイヤの品質評価は、問題なく完了しています。詳細は、[RPT156](#) を参照してください。

## お問い合わせ

この通知に対する回答は必要ありません。その他ご不明な点、ご質問等ございましたら、[ザイリンクス テクニカル サポート](#)までお問い合わせください。

重要なお知らせ :ザイリンクス カスタマー通知 (XCN、XDN、Quality Alert) リリースの通知は、サポートウェブサイト (<http://japan.xilinx.com/support>) から e-mail で受け取ることができます。アカウントご登録後、資料とデザイン アドバイザリ アラートにカスタマー変更通知が含まれるようにカスタマイズしてください。ザイリンクス サポート サイトでは、指定された製品に関する新規および更新情報、データシートやエラーッタ、アプリケーション ノートなどに関するアラートを受け取ることができるサービスを提供しています。登録方法は、[ザイリンクス アンサー 18683](#) を参照してください。

## 参考資料

品質評価レポート (RPT156)

<https://secure.xilinx.com/webreg/clickthrough.do?cid=173884>

## 改訂履歴

次の表に、この文書の改訂履歴を示します。

日付	バージョン	改訂内容
2011/08/15	1.0	初版リリース

## Notice of Disclaimer

The information disclosed to you hereunder (the "Materials") is provided solely for the selection and use of Xilinx products. To the maximum extent permitted by applicable law: (1) Materials are made available "AS IS" and with all faults, Xilinx hereby DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS, EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT, OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE; and (2) Xilinx shall not be liable (whether in contract or tort, including negligence, or under any other theory of liability) for any loss or damage of any kind or nature related to, arising under, or in connection with, the Materials (including your use of the Materials), including for any direct, indirect, special, incidental, or consequential loss or damage (including loss of data, profits, goodwill, or any type of loss or damage suffered as a result of any action brought by a third party) even if such damage or loss was reasonably foreseeable or Xilinx had been advised of the possibility of the same. Xilinx assumes no obligation to correct any errors contained in the Materials, or to advise you of any corrections or update. You may not reproduce, modify, distribute, or publicly display the Materials without prior written consent. Certain products are subject to the terms and conditions of the Limited Warranties which can be viewed at <http://www.xilinx.com/warranty.htm>; IP cores may be subject to warranty and support terms contained in a license issued to you by Xilinx. Xilinx products are not designed or intended to be fail-safe or for use in any application requiring fail-safe performance; you assume sole risk and liability for use of Xilinx products in Critical Applications: <http://www.xilinx.com/warranty.htm#critapps>.

この通知は参照用として、英語版 (XCN11002、バージョン 1.0、2011 年 8 月 15 日発行) を翻訳したものです。